

微量滴胶
效果完美！



1 微升 $\pm 1\%$

preeflow[®]
by ViscoTec

preeflow® 单组份点胶泵

运用系统研究法的品牌。从控制单元到点胶泵，preeflow® - 的产品都符合“个小、经济、精密、精准、精致”的宗旨。

eco-PEN300

最小投配量
0.001 毫升
容积流量
0.12-1.48 毫升/分钟
约计重量
380 克

eco-PEN450

最小投配量
0.004 毫升
容积流量
0.5-6.0 毫升/分钟
约计重量
410 克

eco-PEN600

最小投配量
0.015 毫升
容积流量
1.4-16.0 毫升/分钟
约计重量
750 克

eco-PEN700^{3D}

最小投配量
0.060 毫升
容积流量
5.30-60.0 毫升/分钟
约计重量
750 克



原始尺寸

preeflow[®] 单组份控制器

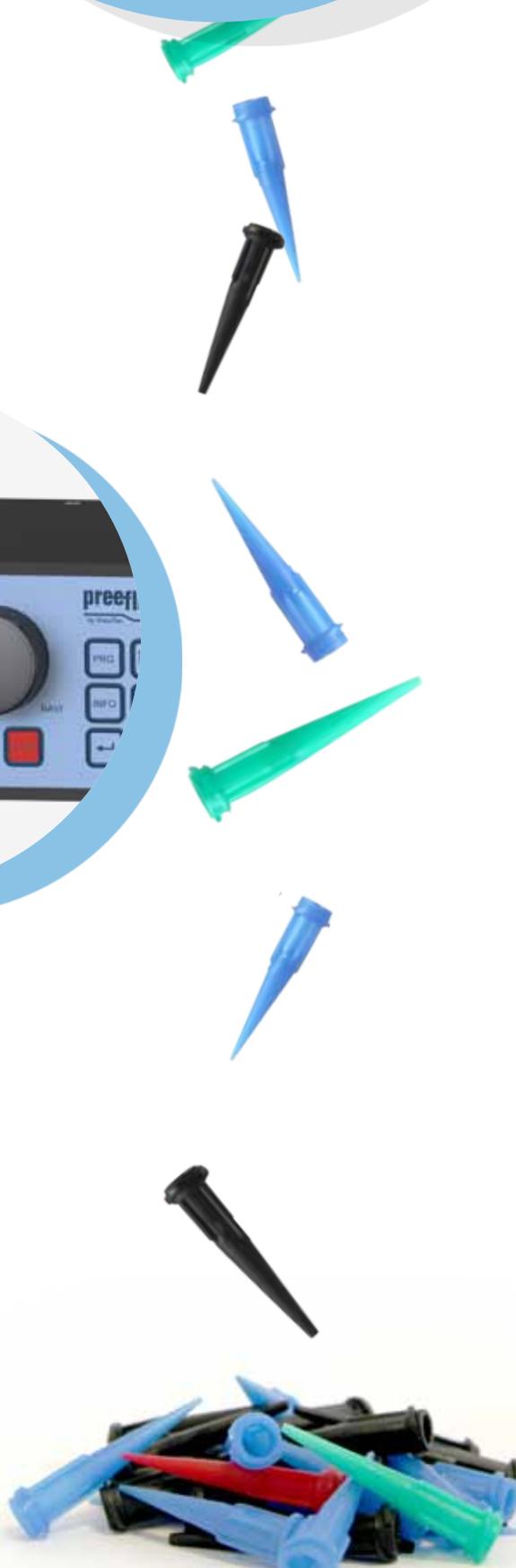
EC200-K



EC200-B



plug'n'dose



preflow[®] 双组份控制器

原始尺寸



eco-DUO450
最小投配量
0.010 毫升
容积流量
0.2-12.0 毫升/分钟
约计重量
1,100 克

新产品
eco-DUO600
最小投配量
0.030 毫升
容积流量
0.6-32.0 毫升/分钟
约计重量
1,600 克

new!

精密机械与最新数字控制技术的完美结合。
为优化您的双组份工艺而设计。
preeflow® - 微量滴胶 效果完美！

preeflow® 双组份控制器

EC200-DUO



New!

新产品 plug'n'mix



您可以在我们的网站上找到更多关于双组份设备和其他 preeflow® 产品信息。
网址：www.preeflow.com



益处和技术

介质在此处理过程中不会发生改变。轻松调到自吸模式，**preeflow**® 保证材料和介质停止输送过程清洁可控。无滴漏、脏乱现象 - 品质一如既往！

preeflow®
by ViscoTec

超过20年的点胶经验

我们的愿景 - 一直保持领先

完美的精密计量技术

我们专注于为您解决问题

非常容易上手操作

提供全球
24小时/7天
支持



技术:

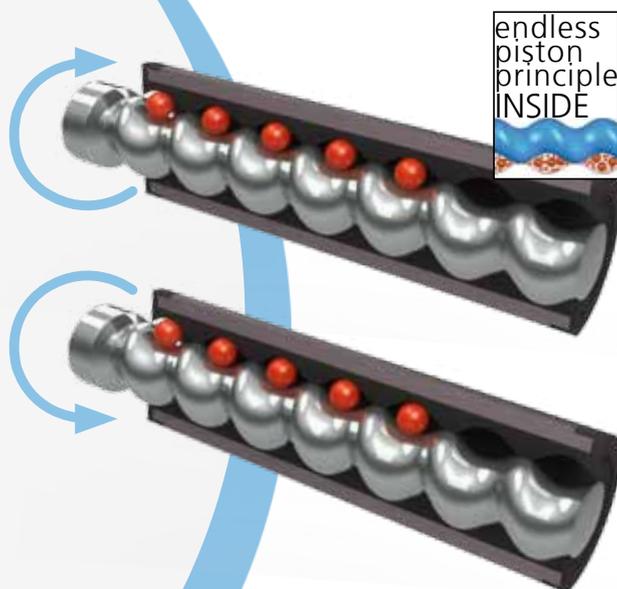
preeflow® 点胶泵的定量原理与连续循环泵送点胶泵的原理相同。

这种先进的定量几何特殊产品结构设计使介质输送平稳，无间断、无脉冲。（回吸功能）防止滴漏，有效控制介质的拉丝和滴漏现象。

由于低剪应力和低压为高粘度且内部具有填充物的特殊敏感介质提供温和处理方式，有效保护介质特性。

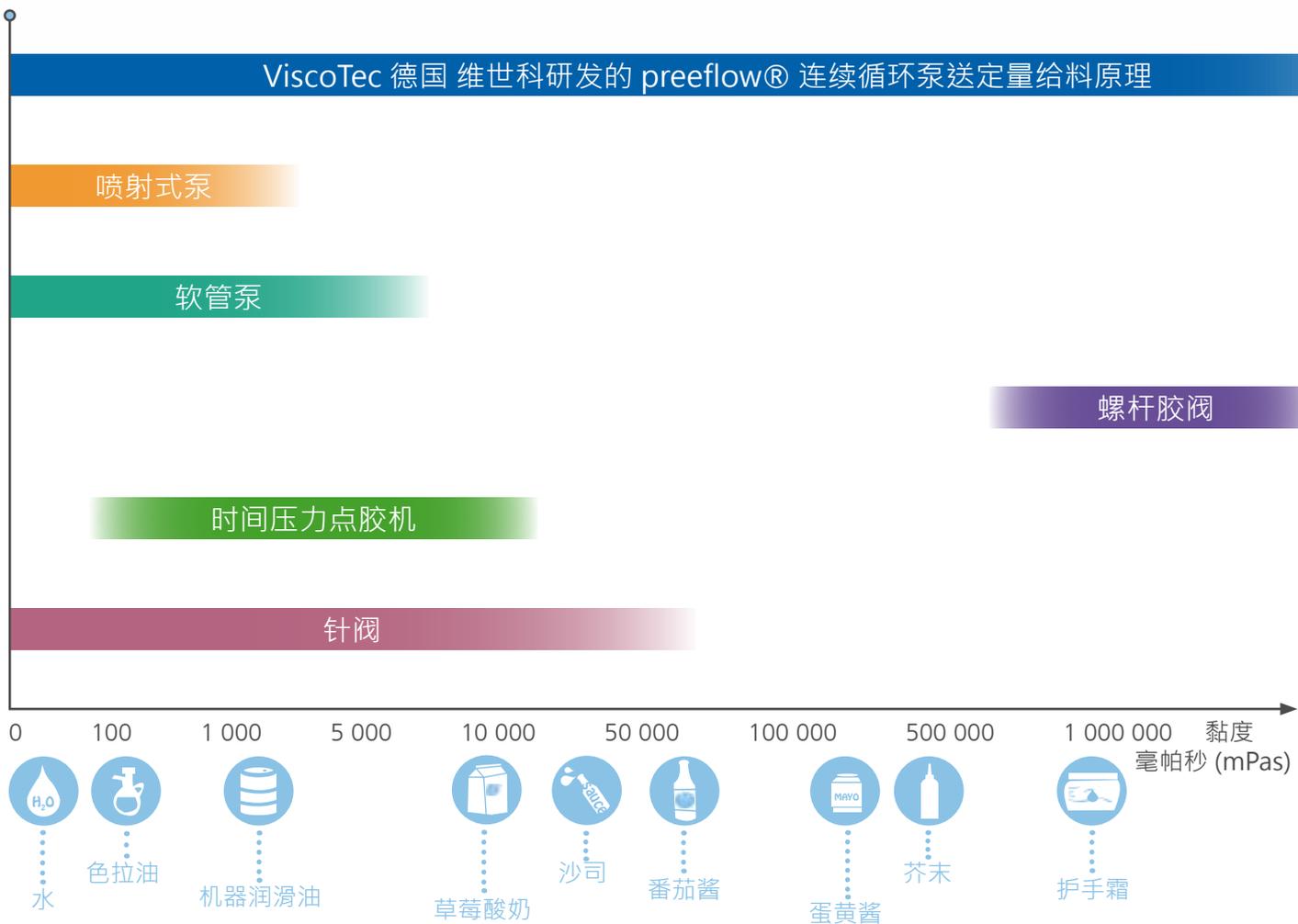
因此，这就是：多重任务，一个解决方案！

preeflow® 可处理以下任务：保形涂敷、密封、粘合、微滴胶、围坝填充、底部填充、顶部封装

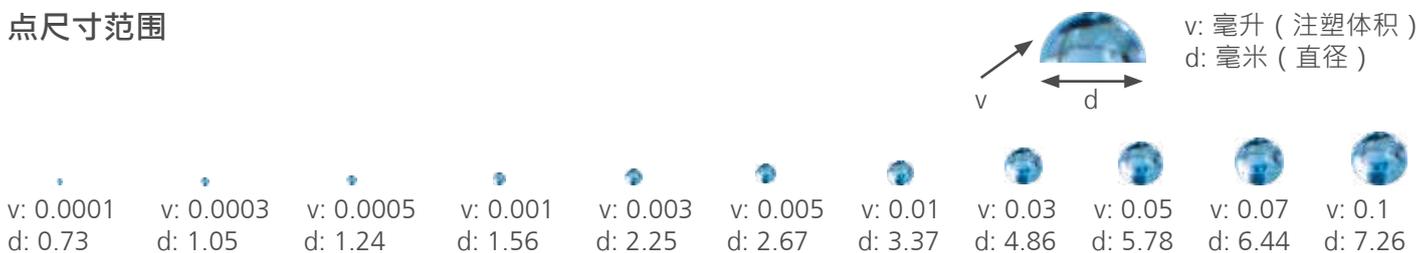




定量投料技术的应用：

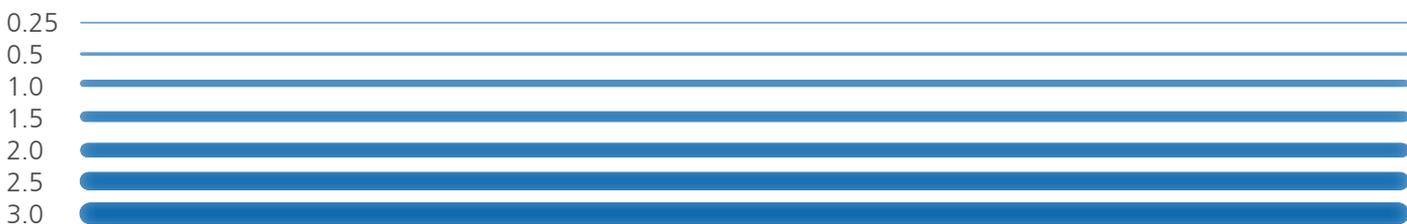


点尺寸范围



珠滴尺寸范围

(毫米)



应用焦点

preeflow® 产品提供理想性能，以此来保证单组份和双组份在相关产业中取得完美配量效果！

最大颗粒容积
1毫米

连续循环泵送定量
给料原理

粘合

在工业行业中，粘合指的是在保障安全的前提下，特别是在利用胶黏剂、化学物质，在高温或有压力的情况下将物体胶接粘合在一起。在我们这里，任何种类的原材料都是可以利用胶黏剂粘合在一起的。因此，粘合技术代替了更多的传统工艺，诸如铆钉和焊接。



容易与机械设备
一体化

重复性大于99%

可回吸物料流

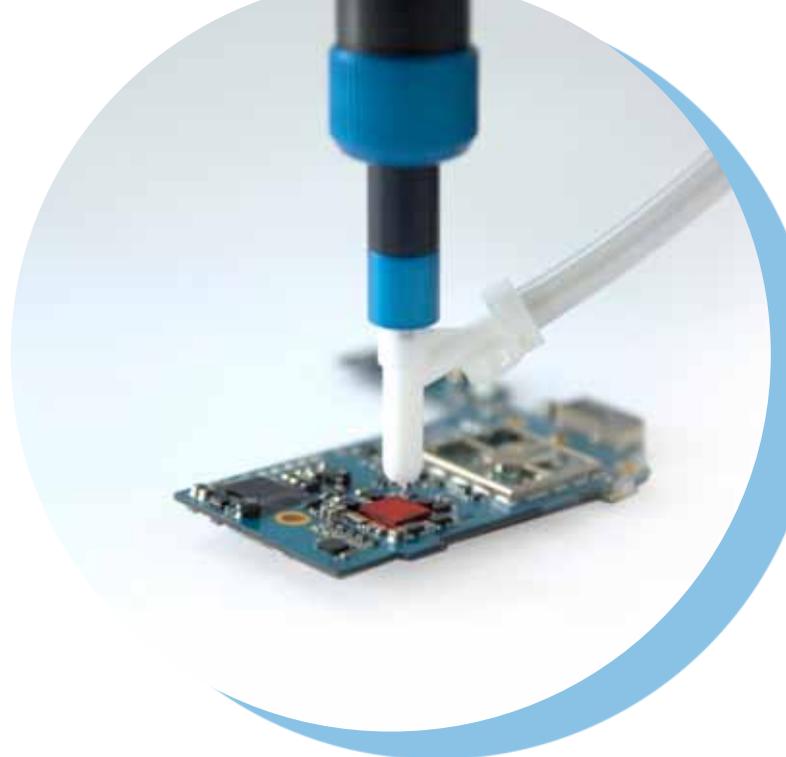


光学粘合

光学粘合是指运用明胶将触屏显示器中玻璃层粘合在一起的一种方法。这种粘合程序的主要目的是提升显示器在户外的表现。这一步骤可消除玻璃层与显示器之间的缝隙，使得两者紧密贴合。我们特别重视在智能手机和平板电脑制造领域保持高水准的计量精度。

保形涂敷

保形涂敷是利用不透明或透明清漆对整块印刷电路板 (PCB) 或其部分进行保护性涂敷的一种方式。材料经常高热粘性热固化或UV固化材料，利用薄膜或厚膜的方法运用在这些材料涂敷于印刷电路板 (PCB) 上。

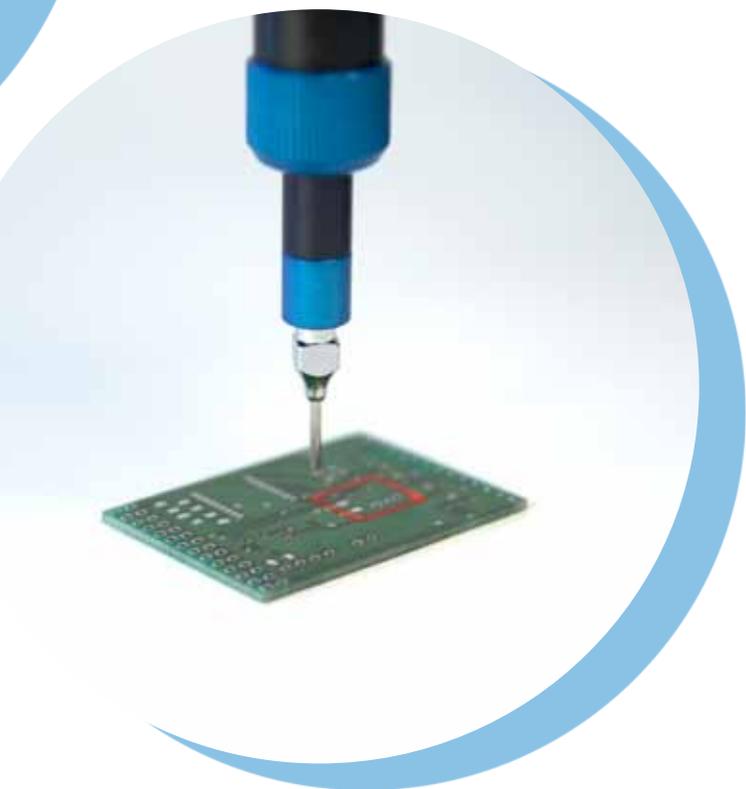


气泡含量
< 2%

无拉丝·无
滴漏

不受压力、
温度和时间影响

粘度范围广



围坝填充

在“围坝填充”技术中，首要的任务是保护高度复杂的装配部分。首先，将需要密封的、被称为“坝”的高粘度的胶状屏障涂在集成板表面。接着接合处被填充进了粘合物，产生保护和密封的作用。

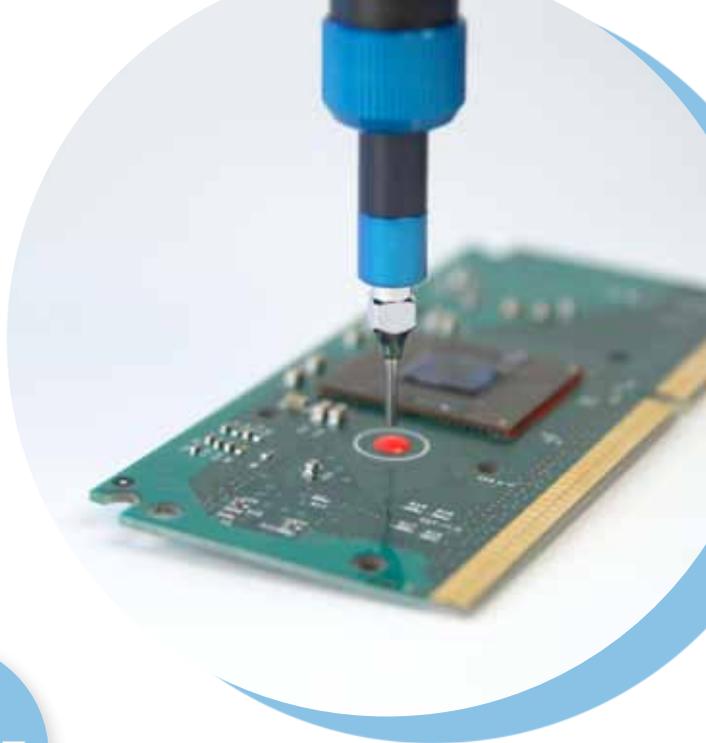
快速点胶

无脉动

固液体
联合填充

顶部封装

顶部封装的设计通常是用来保护半导体芯片这种敏感元件不受温度变化等机械压力的影响。同时也防止外部环境如潮湿、腐蚀对密封的元件产生影响。通过应用液状树脂基质，主要是固化的环氧树脂粘合剂来获得成效。



温和处理产品

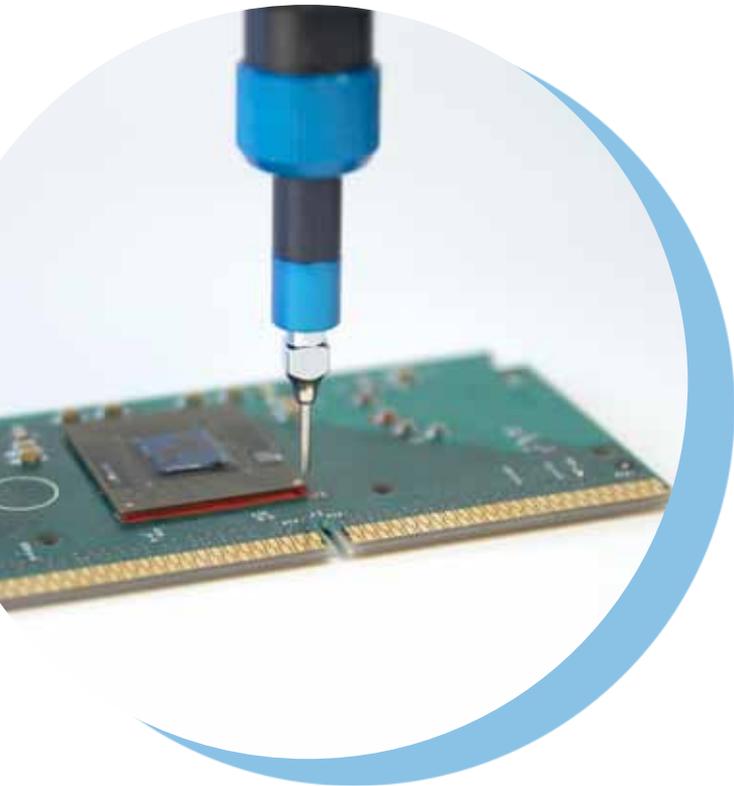
可重复结果

纯容积式定量

容易清洗

底部填充

底部填充通常与各向同性导电胶一起应用。在这种情况下，各项同性导电胶使得微型芯片与基质之间形成电气连接。因为这种粘合剂并不适用于整个表面，在热气或紫外线固化程序后，必须要填充凹陷的空间，所以称之为“底部填充”。



精密准确的容量控制

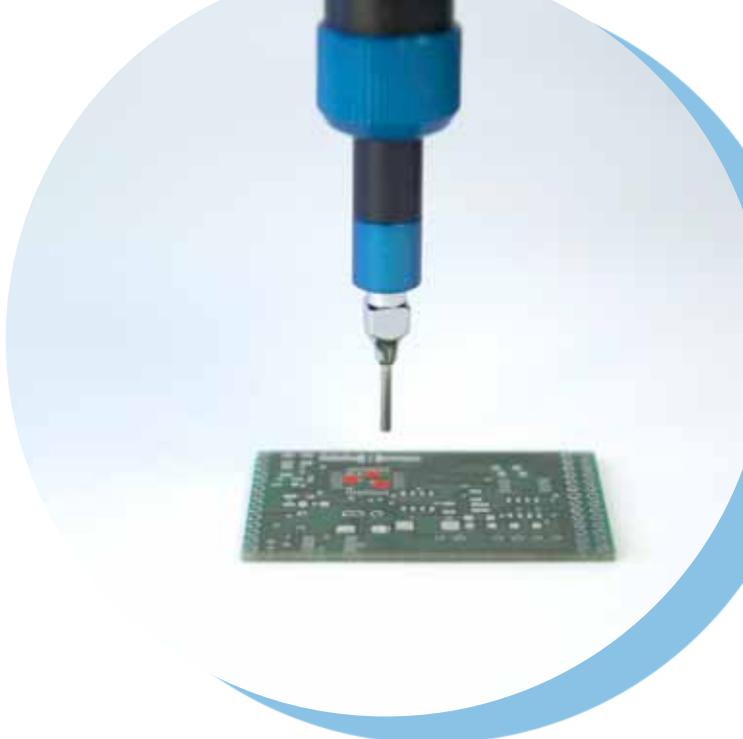
每秒多达三次喷射

应用材料

- 单组份环氧树脂
- 热固化
- 汽油
- 紫外线(UV)固化与光固化
- 双组份环氧树脂
- 厌氧胶黏剂
- 剪切敏感的胶黏剂
- 汽油
- 甲苯
- 剪切敏感的胶黏剂
- 热导电胶
- 封闭剂
- 高填充流体

流体路径短

自动封闭
排水系统



微量点胶

微量点胶指的是在液体基质容量为几微升的情况下进行点胶。其应用领域例如：珠型点胶·密封·点胶·铸封和双组分应用等。这些应用领域对精度、重复精确度和可靠性有特别高的要求。

压力稳定

水状到高粘度
液体

计量精度
± 1 %



封装

封装是将原件或物体表面的小型或固定区域用流体封闭剂进行密封操作。密封胶保护电子元件在运输过程中不受影响，也防止受到诸如振动、摇晃、湿气、灰尘以及极端温度等外部影响。优点包括更高效的电器绝缘，更高的安全性能以防止毁坏，以及最佳的抗化学腐蚀性能。

焊料

颜料及墨水

热油脂

丙酮

化妆品和医药

环氧树脂

聚氨酯 (PU)

丁酮 (MEK)

油膏

处理剂

酒精

等等.....

电解溶液

焊膏

室温硫化硅橡胶

银涂料

焊剂

生物混悬剂

香水

硅

工业用油

丙醇



preeflow®

by ViscoTec

- e**asy dosing technology
- e**asy handling, easy dispensing
- e**xact, precise dosing
- e**ffective dosing
- e**conomic, saves up to 30% of the medium

More information: www.preeflow.com

THE ORIGINAL!

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH
Amperstr. 13 | 84513 Töging a. Inn | Germany

E-Mail: mail@viscotec.de
Internet: www.viscotec.de

Telefon: +49(0)8631/9274-0
Fax: +49(0)8631/9274-300

ViscoTec

我们大中华地区的分公司：